



創變智造新未來

# 台達 3D ToF 智能相機 DMV-T 系列

台達 3D ToF 智能相機整合 ToF 成像、感測以及電腦運算能力，設計小巧、輕量且高效，可在不同光線環境下進行高解析影像取像，並提供精準 3D 物件深度 (depth) 資訊；透過其內建的雙核 ARM 處理器，可即時進行圖像運算。

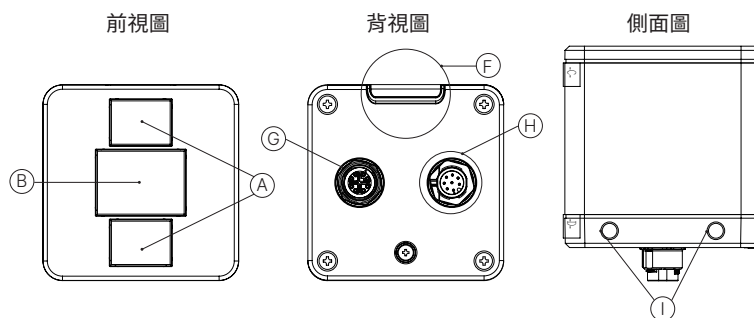
DMV-T 搭配台達 DIAVision 機器視覺軟體，可實現物件測量、辨識、定位等任務，適合物件偵測與機器人視覺等各式應用。

## 功能特色

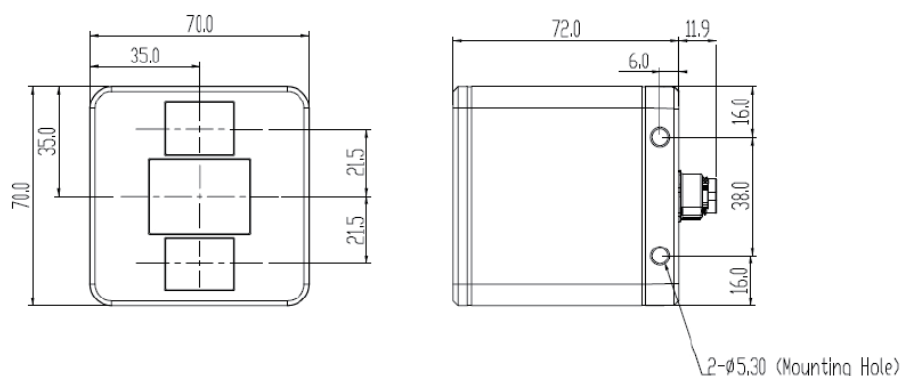
- 60 fps 高速動態取像
- 640 × 480 高影像解析度
- 6 公尺最佳拍攝距離
- 搭載 Arm Cortex-A53 雙核心處理器
- 採用標準 GenICam、支援乙太網路供電
- 通過 IP67 防護、IEC 震動測試

## 產品速覽

編號	名稱
A	VCSEL 雷射器
B	鏡頭
F	LED 指示燈
G	X-CODE 接頭
H	A-CODE 接頭
I	安裝孔 (M5 螺絲)



## 外觀尺寸



## 配件

A-Code Cable P/N	Cable Length
DMV-CAFM5ML8	5,000 ± 5% mm
DMV-CAFM15ML8	15,000 ± 5% mm

X-Code Cable P/N	Cable Length
DMV-CAFM5MG6	5,000 ± 5% mm
DMV-CAFM15MG6	15,000 ± 5% mm

## 產品規格

型號	DMV-TI300GSM			
感測技術	iToF (間接飛時測距)			
解析度 (像素)	640 × 480			
感測器	Sony IMX556 ToF 圖像感測器			
像素大小 (微米)	10			
幀率 (幀/秒)	60			
雷射光波長 (奈米)	850			
視野	67° × 51°			
非模糊操作範圍	單頻：1.5 m、1.875 m、2 m、3 m、4 m、5 m		雙頻：6 m、7.5 m、8 m	
建議工作範圍 (米)	6			
建議目標反射率	20% ~ 90%			
精確度	< 1%			
距離解析度 (毫米)	1			
曝光範圍	1μs ~ 1ms			
中央處理器	Dual Cortex-A53 1.2 GHz			
記憶體	2 GB			
內部儲存空間	8 GB			
作業系統	Linux			
介面	10/100/1,000 Mbps 乙太網路，符合 GigE Vision 2.0 標準			
I/O	2 個光隔離輸入 2 個光隔離輸出	1 個隔離輸入共同接地點 1 個隔離輸出共同接地點	1 個電源輸入 1 個接地	
LED 指示燈	1 個電源 (綠)	1 組狀態 (綠/紅/橘)	1 個使用者定義 (綠)	1 個使用者定義 (紅)
供電方式	PoE：IEEE 802.3bt		直流：24V ± 10%	
功率	一般值：15 W		高峯值：40 W	
接頭	1 組 M12 X-Code Ethernet 連接器		1 組 M12 A-Code 8 pin I/O 連接器	
外殼尺寸 (L × H × W) (毫米)	72 × 70 × 70			
重量	500 g			
認證	IP66, IP67, CE, KC, UL			
雷射安全等級	Class I			
溫度	儲藏：-40 °C to 85 °C		操作：0 °C to 45 °C	
震動	IEC60068-2-6, 5 Hz ≤ f ≤ 8.4 Hz；單次振幅：3.5mm, 8.4 Hz < f ≤ 150 Hz；加速度：1G			
撞擊	IEC60068-2-27 半正弦波；加速度：15G；3 軸 6 方向；各 3 次			

台達電子工業股份有限公司

機電事業群

33068 桃園市桃園區興隆路 18 號

TEL: 886-3-3626301

FAX: 886-3-3716301

DELTA\_IA-MVS\_DMV-T\_F\_TC\_20231108

